

CEI 60749-22  
(Première édition – 2002)

**DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –  
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES  
ET CLIMATIQUES –**

**Partie 22: Robustesse des contacts soudés**

IEC 60749-22  
(First edition – 2002)

**SEMICONDUCTOR DEVICES –  
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –**

**Part 22: Bond strength**

## **CORRIGENDUM 1**

Page 6

*Au lieu de:*

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2012.

*lire:*

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

Page 7

*Instead of:*

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2012.

*read:*

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.